SEMICON JAPAN 2019

参加レポート

群馬大学 群馬大学理工学府 理工学専攻
電子情報･数理教育プログラム
小林研究室 修士 1 年 李雄炎

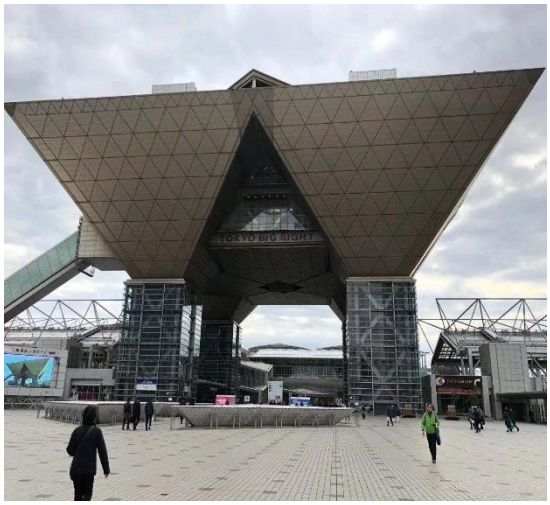
1.イベント概要

SEMICON JAPAN 2019

https://www.semiconjapan.org

2.開催場所

東京ビッグサイト 西展示棟

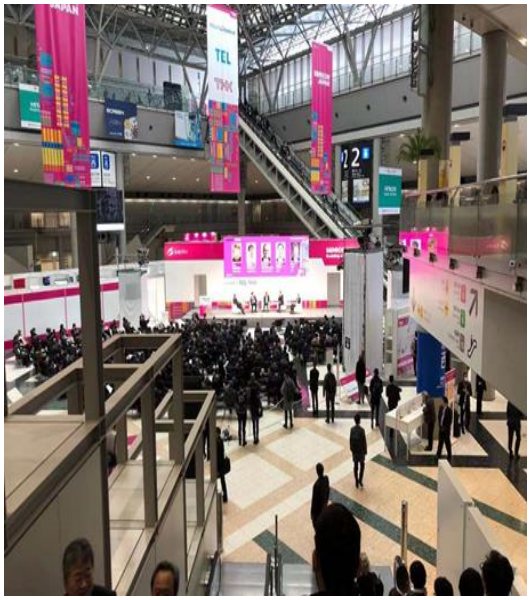


3.開催期間

2019/12/11(水)～12/13(金) 3 日間共通 10：00－17：00

4.イベント概要

日本で唯一、半導体製造の全工程の製造技術・装置・材料をカバーする大規模展示会です。現在の半導体製造は前工程と後工程の境界がなくなりつつあり、全工程を通した技術情報の提供が展示会に求められています。マイクロエレクトロニクス展示会としては世界最大級、日本で随一の規模を誇ります。



5. 参加イベント報告

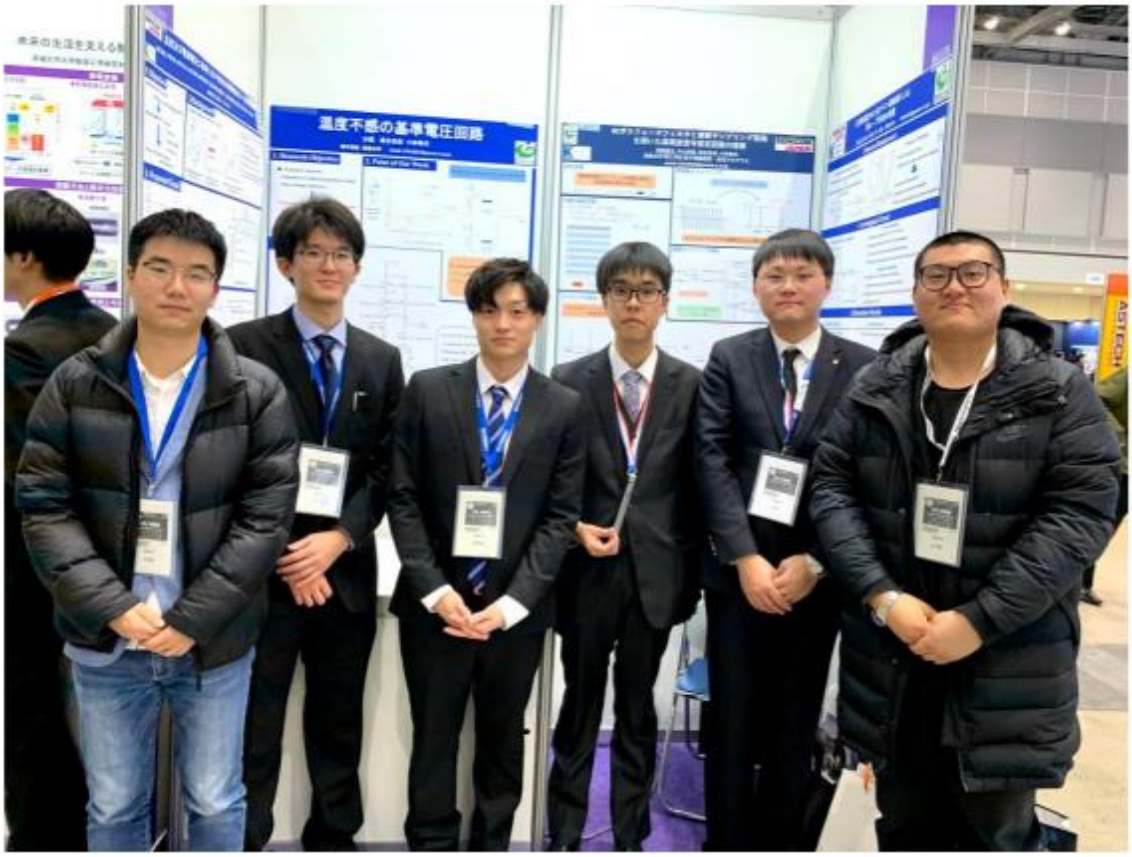
私はセミコンジャパン 2019 で様々な先端技術の会社の技術成果を見学しながら、中国でこういう技術成果をあげることができるかどうかを考えました。

今の時点で半導体分野における中国はまだ日本と実力差があると思います。

これから勉強をもっと頑張って、先進技術を創造できるようになることを目指したいと思います。

6.謝辞

群馬大学小林研究室の一員として、セミコンジャパンに参加したことを心から光栄に思います。セミコンジャパン参加の機会を与えて頂いた小林春夫先生、参加にあたり様々なサポートをして頂いた桑名杏奈先生、小林春夫研究室ブースにお立ち寄り頂いた皆様に深く感謝申し上げます。


温度不感の基準電圧回路